

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-20

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u> 券商策略会 </u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	交银施罗德基金、鑫元基金、交银康联、盛宇投资、国联安、顾臻投资、敦和资产、西藏东财基金、丹羿投资、毅木资产、中金资管、长盛基金、国泰基金、工银安盛、太平基金、西部利得基金、兴银理财、兆天资产、海富通基金、煜德投资、国投瑞银、诺德基金、易方达基金、太平洋资产、华安基金、信诚基金、浦银安盛、圆信永丰、申万菱信
时间	2024年5月6日
地点	中泰证券策略会举办地（上海）
上市公司接待人员姓名	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司2024年一季度经营业绩情况。</p> <p>2024年一季度，电子产业需求整体保持平稳修复趋势，较去年一季度下游市场需求承压的情形有所改善，PCB、封装基板、电子装联三项业务营业收入同比均有提升。报告期内，公司实现营业收入39.61亿元，同比增长42.24%，归母净利润3.80亿元，同比增长83.88%，扣非归母净利润3.36亿元，同比增长87.43%。</p> <p>Q2、请介绍公司2024年一季度PCB业务各下游领域经营拓展情况。</p> <p>2024年一季度，公司PCB业务通信领域无线侧订单需求较去年第四季度未出现明显改善，有线侧交换机、光模块等需求有所增长。数据中心领域订单需求环比继续增长，主要得益于Eagle Stream平台产品逐步起量，叠加AI加速卡等产品需求增长。汽车电子领域继续把握在新能源和ADAS方向的机会，延续往期需求。工控医疗等领域业务占比相对较小且需求相对保持平稳。</p>

Q3、请介绍当前 AI 领域的发展对公司 PCB 业务产生的影响。

伴随 AI 的加速演进和应用上的不断深化，ICT 产业对于高算力和高速网络的需求日益紧迫，各类终端应用对边缘计算能力和数据高速交换与传输的需求迎来增长。上述趋势驱动了终端电子设备对高频高速、集成化、小型化、轻薄化、高散热等相关 PCB 产品需求的提升。公司 PCB 业务在高速通信网络、数据中心交换机、AI 加速卡、存储器等领域的 PCB 产品需求将受到上述趋势的影响。

Q4、请介绍公司 PCB 业务 HDI 工艺能力及相关产品布局情况。

HDI 作为一项平台型工艺技术，能够实现 PCB 板件的高密度布线。公司 PCB 业务具备包括 Any Layer（任意层互联）在内的 HDI 工艺能力，主要应用于通信、数据中心、工控医疗、汽车电子等下游领域的部分中高端产品。

Q5、请介绍公司 PCB 各工厂是否区分不同下游领域安排生产。

公司在深圳、无锡、南通拥有多个 PCB 工厂。除部分专业工厂外，公司主要根据不同 PCB 产品的工艺要求特征来安排生产，产线本身对工艺相似的不同下游领域产品具有一定兼容性。

Q6、请介绍公司 2024 年一季度封装基板业务经营拓展情况。

2024 年一季度，公司封装基板业务需求整体延续去年第四季度态势。BT 类封装基板保持稳定批量生产，FC-BGA 封装基板各阶产品对应的产线验证导入、送样认证等工作有序推进。

Q7、请介绍公司封装基板业务主要产品类型。

公司生产的封装基板产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。公司目前已形成具有自主知识产权的封装基板生产技术和工艺，建立了适应集成电路领域的运营体系，具备了包括 WB、FC 封装形式全覆盖的 BT 类封装基板量产能力，并持续推进 FC-BGA 产品在广州封装基板项目的平台能力建设。

	<p>Q8、请介绍公司无锡基板二期工厂、广州封装基板项目连线爬坡进展。</p> <p>公司无锡基板二期工厂于 2022 年 9 月下旬连线投产，目前已实现单月盈亏平衡。广州封装基板项目一期已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。公司将持续推进无锡基板二期工厂能力提升，加快广州 FC-BGA 产品线竞争力建设，支撑无锡、广州封装基板项目顺利爬坡。</p> <p>Q9、请介绍公司目前工厂整体稼动率情况。</p> <p>近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。</p> <p>Q10、请介绍公司泰国项目规划及当前建设进展。</p> <p>公司为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，在泰国投资建设工厂，总投资额为 12.74 亿元人民币/等值外币。目前已办理完成泰国子公司的备案登记事宜，并先后收到国家发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》、国家商务部颁发的《企业境外投资证书》。签订土地购买协议，出资 2.89 亿泰铢购买约 70 莱的洛加纳工业园区内工业用地，并已筹备开展各项建设工作，具体投产时间将根据后续建设进度、市场情况等因素确定。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2024 年 5 月 6 日